



规格书

名称:

SMD石英晶体谐振器

1 适用范围

本规格书用于规定 (A)MHz石英晶体谐振器。

A: 26.000000 MHz

2 构造

2.1 封装 3.2*2.5

2.2 封装形式

1.冷压焊

2.电阻焊

3.锡焊

2.3 封装介质

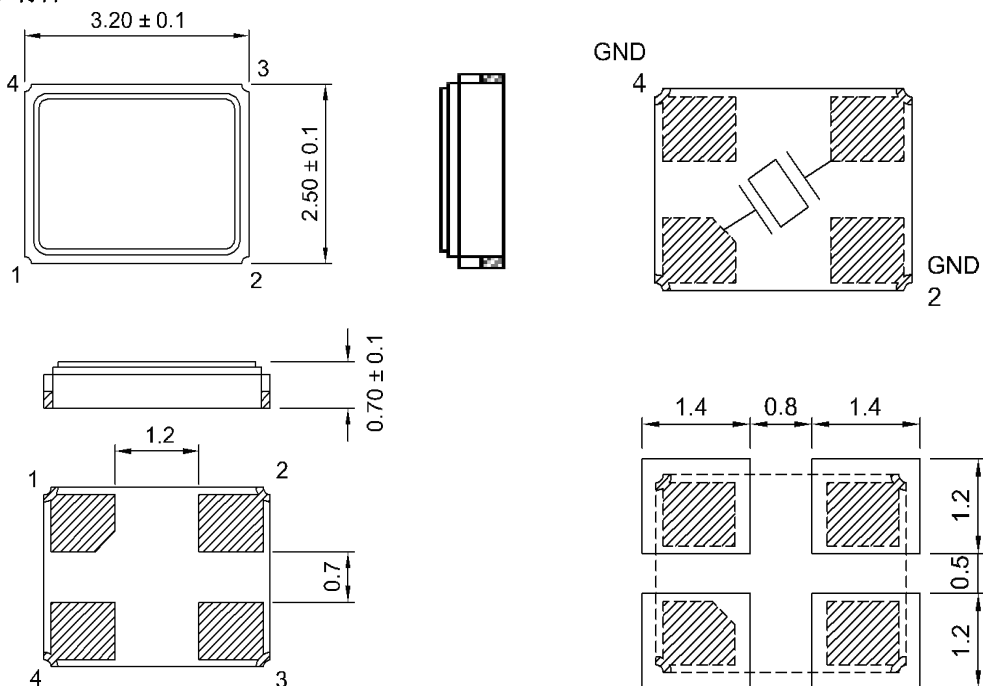
1.

氮气

2.

真空

3 尺寸、材料



单位: mm

材料表

I	外壳	锌白铜/镀镍银合金或锌白铜
II	引线	镀金点
III	基座	陶瓷

4 部品编号

部品编号	频率偏差	标称频率
26MC8.5P	± 10 PPM	26.000000 MHz

5.1 性能

- 标准状态

除特别规定，在以下标准大气状态下测试：常温：5~35℃；常湿：（相对湿度）45~85%；。

常压：气压86~106kPa

但：对结果有疑义时，测试应在以下范围内：温 度：20±1℃；相对湿度：63~67%；

- 使用温度范围

工作温度范围指石英晶体谐振器连续工作周围温度：-20℃~+70℃。

- 保存温度范围

保存温度范围指石英晶体谐振器贮存温度：-40℃~+85℃。

5.2 Electrical characteristical 电气性能

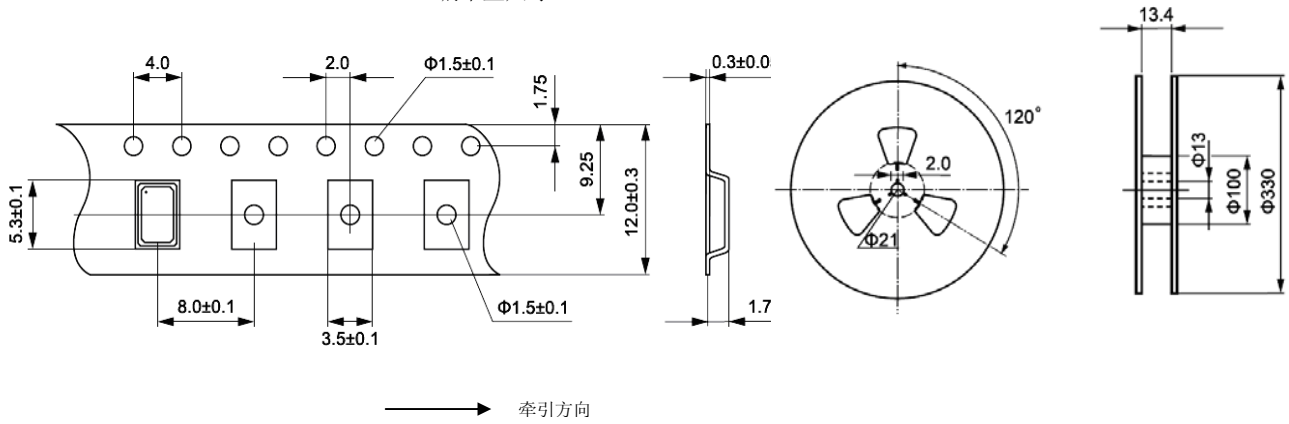
	项目	条 件	规格
1	标称频率		26.000MHZ
2	振动模式		基频
3	负载电容		8.5p F
4	激励电平		100uw±20%
5	谐振电阻	依据标准试验电路	≤ 60 Ω
6	并电容		7.0pf MAX
7	频率偏差	依据试验电路	±10ppm 以内
8	温度偏差	温度频差测试的基准温度是:25±2℃	±20ppm 以内
9	寄生衰减量	在中心频率:F ₀ ±500KHz 范围内的次谐波衰减量	≥3dB
10	绝缘电阻	DC100V, 1分钟。测量两引线、引线与外壳之间绝缘电阻	≥500M Ω

5.3 机械性能及耐久性能					
	项目	条件	规格		
1	端子强度	拉力和推力 按IEC 68-2-21中试验Ua1(拉力)和试验Ua2(推力)进行,拉力10N	端子不会损坏和松散.满足电气性能及机械性能.		
	可焊性	按IEC 68-2-20中试验Ta的方法1进行。	(1)浸锡时间3秒以内 (2)引线挂锡面积95%以上		
	耐焊接热	规定以下其他方法:可参考IEC Pub. 68-2-20 测试Tb方法1,焊条在 260℃ 温度方法2,焊铁在350℃温度 焊条方法 焊接温度: 260 ±5 °C 浸入时间:10 ±1秒 热冲击厚度(印制电路板):1.6毫米 电烙铁方法 烙块温度: 350 ±5 °C 焊接时间:3 +10秒	端子无松动无裂纹, 电气性能可满足要求:电阻在规格范围内, 频率变化量小于10ppm.		
4	耐振性	按IEC68-2-6试验Fc进行	无松动、裂纹, 电气性能可满足要求6.2.5, 6.2.7要求, 且频率变化量在5ppm以内		
5	耐冲击性	按IEC68-2-27试验Ea进行	无松动、裂纹, 电气性能可满足要求6.2.5, 6.2.7要求, 且频率变化量在10ppm以内		
6	寒冷	按IEC68-2-1试验Aa进行, 持续时间2小时。	满足要求6.2.5 6.2.7要求,且周波数变化量在10ppm以内		
7	干燥	晶体在温度: 85±2℃中放置2小时后, 在常温常湿状态下放置1小时后测试。	电气性能可满足要求6.2.5 6.2.7要求,且周波数变化量在5ppm以内		
8	耐湿性	晶体在温度: 40±2℃, 湿度90~95%中放置48小时后, 在常温常湿状态下放置1小时后测试,	电气性能可满足要求6.2.5t 6.2.7要求,且周波数变化量在5ppm以内		
	温度冲击	温度	电气性能可满足要求:周波数变化量小于5ppm		
		1		-40±3℃	30分钟
		2		常温	30秒以内
		3		100±2℃	30分钟
		4	常温	30秒以内	
	盐水喷雾	温度35±2℃,浓度(重量比)5±1%连续盐水喷雾48小时,常温恢复1小时后测试; 其它参见IEC Pub. 68-2-11	目视表面无腐蚀, 测定结果满足6.2.5和6.2.7		
11	气密性	酒精加压0.5kg压力,加压时间30分钟; 测量引线与引线,之间绝缘电阻 (100V直流电压,时间1分钟)	端子之间的绝缘电阻≥500MΩ(100V DC)		
12	老化	晶体在温度: 85±3℃中放置720小时 (30天) ±12小时后, 在常温常湿状态下放置1小时后测试。	电气性能可满足6.2.5,6.2.7的要求		

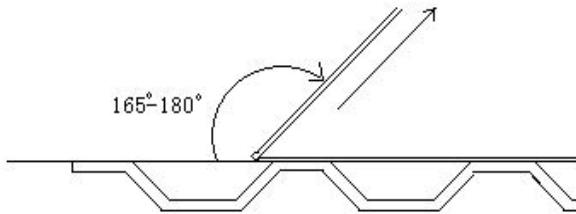
6. SMD编带、带盘规格尺寸图

6.1

编带盘尺寸



剥离方式见下图，强度：0.1N-0.7N



引出方向 (Lead direction)

6.2 焊接条件

